



中华人民共和国国家标准

GB/T 47350—2026

电接触材料分类及判定

The classification and assessment for electrical contact materials

2026-03-31 发布

2026-10-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 分类原则	2
5 A类-银基电接触材料	2
5.1 A1-纯银	2
5.2 A2-细晶银	3
5.3 A3-银铈	3
5.4 A4-银铜	4
5.5 A5-银钯	4
5.6 A6-银铁	5
5.7 A7-银镍	6
5.8 A8-银石墨	6
5.9 A9-银钨	7
5.10 A10-银镍石墨	7
5.11 A11-银氧化铜	8
5.12 A12-银氧化镉	8
5.13 A13-银氧化锡	9
5.14 A14-银氧化锡氧化铜	9
5.15 A15-银氧化锌	10
5.16 A16-银氧化铁	10
5.17 A17-银碳化钨	11
5.18 A18-银碳化钨石墨	11
6 B类-铜基电接触材料	12
6.1 B1-铜钨	12
6.2 B2-铬铜/铬锆铜	12
6.3 B3-铜碳化钨	13
6.4 B4-铜钨碳化钨	14
6.5 B5-铜石墨	14
6.6 B6-铜金刚石	15
6.7 B7-铜铬	15
6.8 B8-铜碳化钨石墨	16

6.9	B9-铜钼	16
7	C类-金基电接触材料	17
7.1	C1-金镍合金	17
7.2	C2-金银合金	17
7.3	C3-金钯合金	18
8	D类-铂族电接触材料	19
8.1	D1-钯及钯基其他组分合金电接触材料	19
8.2	D2-铂合金电接触材料	19
9	其他电接触材料 E类	20
9.1	E1-铝镀银电接触材料	20
9.2	E2-铜(铜合金)镀银电接触材料	20
9.3	E3-贵廉金属复合材料	21

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电器工业协会提出。

本文件由全国电工合金标准化技术委员会(SAC/TC 228)归口。

本文件起草单位：桂林电器科学研究院有限公司、浙江福达合金材料科技有限公司、桂林金格电工电子材料科技有限公司、陕西斯瑞新材料股份有限公司、佛山通宝精密合金股份有限公司、河北工业大学、温州聚星科技股份有限公司、安徽鑫瑞新材料有限公司、苏州市希尔孚新材料股份有限公司、三友联众集团股份有限公司、中国电力科学研究院有限公司、浙江省冶金研究院有限公司、温州宏丰电工合金股份有限公司、天水西电长城合金有限公司、河南科丰新材料有限公司、浙江至信新材料股份有限公司、浙江松发复合新材料有限公司、沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司、贵研中希(上海)新材料科技有限公司、佛山市诺普材料科技有限公司、宁波电工合金材料有限公司、浙江耐迹合金科技有限公司、四川智启贵金属有限公司、吴江市东风电工器材有限公司、昆明理工大学、济源豫金靶材科技有限公司、浙江永裕金具有限公司、红旗集团电力金具有限公司、浙江银通电器有限公司、浙江安瑞电器有限公司、浙江汇永电力设备有限公司、惠州市磁极新能源科技有限公司、南通诚业德精密组件有限公司、湖南省华京粉体材料有限公司、苏福(深圳)科技有限公司、温州德银新材料有限公司、山东航天正和电子有限公司。

本文件主要起草人：崔得锋、柏小平、陈光明、王小军、霍志文、王景芹、黄光临、张晓辉、杨玉才、秦平、丁一、余贤旺、吴新合、张红军、张燕、曹永平、赵成威、杨永泽、李国伟、王永业、张顺乐、陈春、滕汶宋、金华林、周晓龙、尚维国、黄海丹、王春余、戴仲、高勇、龚亮、李衡、黄民清、孙志方、李治国、陈凌霄、赵君、黄岚霞、刘北阳、颜培涛、刘倓、金一晨、韩玉玲、潘君益、叶红梅。

电接触材料分类及判定

1 范围

本文件确立了电接触材料的分类原则,规定了电接触材料的分类及判定方法。
本文件适用于电接触材料的研发生产、试验应用及统计分析等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 228.1—2021 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法
- GB/T 2900.4—2008 电工术语 电工合金
- GB/T 4324.6—2012 钨化学分析方法 第6部分:铁量的测定 邻二氮杂菲分光光度法
- GB/T 4324.27—2012 钨化学分析方法 第27部分:碳量的测定 高频燃烧红外吸收法
- GB/T 5121.1—2008 铜及铜合金化学分析方法 第1部分:铜含量的测定
- GB/T 5121.27—2008 铜及铜合金化学分析方法 第27部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法
- GB/T 5586 电触头材料基本性能试验方法
- GB/T 5588—2017 银镍、银铁电触头技术条件
- GB/T 13397—2024 合金内氧化法银金属氧化物电触头技术规范
- GB/T 15072.1—2025 贵金属合金化学分析方法 第1部分:金含量的测定
- GB/T 15072.2—2025 贵金属合金化学分析方法 第2部分:银含量的测定
- GB/T 15072.3—2025 贵金属合金化学分析方法 第3部分:铂含量的测定
- GB/T 15072.4—2025 贵金属合金化学分析方法 第4部分:钯含量的测定
- GB/T 15072.6—2025 贵金属合金化学分析方法 第6部分:铱含量的测定
- GB/T 15072.8—2008 贵金属合金化学分析方法 金、钯、银合金中铜量的测定 硫脲析出 EDTA 络合返滴定法
- GB/T 15072.10—2008 贵金属合金化学分析方法 金合金中镍量的测定 EDTA 络合返滴定法
- GB/T 15072.13—2008 贵金属合金化学分析方法 银合金中锡、铈和镧量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
- GB/T 15072.17—2008 贵金属合金化学分析方法 铂合金中钨量的测定 三氧化钨重量法
- GB/T 15159 贵金属及其合金复合带材
- GB/T 16921 金属覆盖层 覆盖层厚度测量 X射线光谱法
- GB/T 24268 银氧化锡电触头材料化学分析方法
- GB/T 38145 高含量贵金属合金首饰 金、铂、钯含量的测定 ICP 差减法
- JB/T 4107(所有部分) 电触头材料化学分析方法
- JB/T 6237.1—2008 电触头材料用银粉化学分析方法 第1部分:氯化银沉淀—对二甲替氨基亚苄基罗丹宁分光光度法测定银量